

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Nexchip 晶合集成

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION

合肥晶合集成電路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2249)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第**13.10B**條而做出。

茲載列合肥晶合集成電路股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命

Nexchip Semiconductor Corporation

合肥晶合集成電路股份有限公司

執行董事兼董事長

蔡國智先生

香港，2026年8月24日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、陳小蓓女士、郭兆志先生及邱文生先生；及(iii)獨立非執行董事安廣實教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2026-029

合肥晶合集成电路股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 4 月 26 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
募集资金净额	9,723,516,459.91
加：利息收入扣除银行手续费净额	122,054,018.25
减：募集资金投资项目支出(a+b+c)	8,789,181,314.29
其中：直接投入募集资金项目的金额(a)	5,267,663,497.79

以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b)	2,075,224,554.41
使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额(c)	1,446,293,262.09
减：节余资金永久补充流动资金	831,868,466.31
减：超募资金永久补充流动资金	60,000,000.00
减：超募资金回购公司股份	164,520,697.56
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户应有余额(d)	0
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额(e)	0
差异(d-e)	0

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《合肥晶合集成电路股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 4 月 26 日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
合肥晶合集成电路股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000057	0	2026年3月19日销户
	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000164	0	2026年3月19日销户
	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	181267662902	0	2026年3月18日销户
	中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行	12181001040035296	0	2026年3月18日销户
	招商银行股份有限公司合肥分行	551904996610555	0	2024年7月17日销户
	兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行	499050100100419345	0	2024年7月19日销户
	中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129200389609	0	2024年5月17日销户
	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002618	0	2026年3月19日销户

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本专项报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币 15 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 0。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）”“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”结项，并将节余募集资金 13,304.90 万元（截至 2026 年 1 月 31 日，含扣除手续费后的利息收入、理财收益、尚未支付的款项及用自有资金支付且未置换的发行费用，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所

（www.sse.com.cn）披露的《晶集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-001）。

截至本报告出具日，公司已将节余募集资金 130,760,668.56 元从募集资金存放专项账户转出用于补充流动资金，另有前期以自有资金支付且未置换的发行费用 2,431,486.99 元，本次随节余资金一同转出。公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行开立的账号为 20000515418466600000057、20000515418466600000164 的募集资金专户已于 2026 年 3 月 19 日办理销户手续；在中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行开立的账号为 12181001040035296 的募集资金专户已于 2026 年 3 月 18 日办理销户手续；在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开立的账号为 34050144770800002618 的募集资金专户已于 2026 年 3 月 19 日办理销户手续。

节余募集资金使用情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2023 年 4 月 26 日				
节余募集资金合计金额			130,760,668.56				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）	130,728,028.59	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026 年 2 月 6 日	不适用
28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目	32,639.97	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026 年 2 月 6 日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

2023年6月21日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置换。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-006）。

截至2026年6月30日，公司使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式累计支付了募投项目所需资金共计 1,446,293,262.09 元，以募集资金 1,446,293,262.09 元进行了等额置换。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，董事会同意本次终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”，并将该项目拟投入募集资金35,595.58万元（含现金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）变更投向至其他募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”，并授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项已于2025年5月28日经公司2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-002）、《晶合集成2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-030）。

截至2026年6月30日，变更募投项目具体情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2023 年 4 月 26 日											
半年度投入募集资金总额		3,368,049.20											
已累计投入募集资金总额		9,013,702,011.85											
变更用途的募集资金总额		350,000,000.00											
变更用途的募集资金总额比例		3.60%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2) ^{注1}	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	半年度实现的效益 ^{注3}	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）	研发	否	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	3,368,049.20	475,535,275.01	-124,464,724.99	79.26	2025 年底	不适用	不适用	否
微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）	研发	是	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	终止	不适用	不适用	是

40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	研发	否	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	1,176,243,549.77	-323,756,450.23	78.42	2025 年中	不适用	不适用	否
28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目 ^{注 2}	研发	是	2,450,000,000.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	0.00	2,856,191,557.26	56,191,557.26	102.01	2025 年底	不适用	不适用	否
收购制造基地厂房及厂务设施	生产建设	否	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00	0.00	2,763,936,719.17	-336,063,280.83	89.16	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还贷款	补流还贷	否	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	1,517,274,213.08	17,274,213.08	101.15	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-永久补充流动资金	补流还贷	-	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金-回购公司股份	回购公司股份	-	0.00	163,516,459.91	163,516,459.91	0.00	164,520,697.56	1,004,237.65	100.61	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			9,500,000,000.00	9,723,516,459.91	9,723,516,459.91	3,368,049.20	9,013,702,011.85	-709,814,448.06	—	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	详见本专项报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注 1：“截至期末累计投入金额”包含：直接投入募集资金项目的金额；以募集资金置换预先投入项目的自筹资金金额；使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额；超募资金永久补充流动资金金额，超募资金回购公司股份金额。

注 2：公司终止“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）”并将该项目募集资金投向变更至“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”，此处“调整后投资总额”不含“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）”募集资金实际转出时的利息收入。

注 3：上述募投项目均不直接产生效益，无法单独核算效益。募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）”、“40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”及“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”主要是为了进一步增强公司的研发实力，提高公司的产品市场竞争力，提升公司的持续盈利能力与核心竞争力。“收购制造基地厂房及厂务设施”主要是为了保障生产自主性与资产完整性，降低长期运营成本。“补充流动资金及偿还贷款”项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2023 年 4 月 26 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	半年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目	微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）	研发	晶合集成	安徽省合肥市	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	0.00	2,856,191,557.26	102.01	2025 年底	不适用	不适用	否	2024 年 12 月 30 日	2025 年 5 月 28 日
合计					2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	0.00	2,856,191,557.26	-	-	不适用	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	受主轴产品研发策略和市场需求变化的影响，公司从市场需求、技术投入、投资收益以及成本控制等多个维度重新对募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）”进行评估，认为该项目效益相较于最初预期出现了明显的降低趋势。公司决定整合研发资源并聚焦于公司主力产品，将更多研发力量投向效益更好的研发项目。28 纳米逻辑及 OLED 芯片在市场上展现出巨大的需求潜力，并且公司“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”的开发进展顺利，目前已取得了良好的阶段性成果，公司期望通过扩大投资额，加快推动 28nm 产品的工艺精进及效能提升，以满足客户日益增长且不断变化的需求。鉴于上述情况，公司经慎重考虑决定终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）”，并将该项目募集资金变更投向至其他募投项目“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”，增加“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”的投资总额。本次变更募投项目有利于更快实现效益，拓展产品的应用领域，使公司在激烈的市场竞争中占据更有利的地位，符合公司实际经营需要，具有合理性和必要性。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，董事会同意本次终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）”，并将该项目拟投入募集资金 35,595.58 万元（含现金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）变更投向至其他募投项目“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”，并授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项已于 2025 年 5 月 28 日经公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-002）、《晶合集成 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-030）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用